

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

551

ML8

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	175		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	18	L2	4 A01
		510		
		18	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	165		5
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		6
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	18	L4	7 A02
		510		
		18	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	165		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	18	L6	10 A03
		510		
		18	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	175		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	13

Dicke nach Verpressen

B00:

2290 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2530 µm

Dmin:

2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2400 µm

Tol+:

240 µm

Tol-:

240 µm

Dmax:

2640 µm

Dmin:

2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

2354 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik